

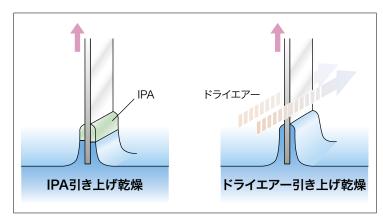




Doc. No.: NR081120 2008年11月20日

## 世界初、VOC排出量ゼロの300ミリ半導体ウエハー洗浄装置を開発 ~環境負荷とランニングコストを大幅に抑制するドライエアー乾燥技術を搭載~

大日本スクリーン製造株式会社はこのほど、300ミリウエハーの半導体デバイス量産ラインにおいて世界初<sup>\*1</sup>となる、IPA (イソプロピルアルコール)を使用しない新たな乾燥技術を開発。同技術を採用した「ドライエアー乾燥モジュール (DAD)」を搭載するバッチ式<sup>\*2</sup>洗浄装置「FC-3100」を、2008年12月から販売します。



☆ この画像の印刷用データ (解像度 300dpi) は、 下記URLよりダウンロードできます。 (www.screen.co.jp/press/nr-photo/)

近年、半導体業界では、デバイス回路の微細化がますます進行する中、処理プロセスの高度化や生産量の増加に伴い、各製造工程で使用される化学物質の排出量も増大しています。ウエハー洗浄工程で使用されるIPAは、大気汚染防止法によって規制されているVOC (揮発性有機化合物)の一種に指定されており、環境負荷の低減に取り組む半導体デバイスメーカーにとって、IPA排出量の削減が大きな課題の一つとなっています。

今回「FC-3100」に搭載するモジュール「DAD」は、極めて露点の低いドライエアー(乾燥空気)をウエハーに吹き付け、洗浄後の水分を瞬間的に除去。IPAを一切使用しないため、VOC排出量ゼロを実現します。また、従来のIPAによる乾燥と同等の性能を実現しながらも、処理時間を約2分の1に短縮し、ランニングコストを最大で8分の1にまで低減<sup>\*3</sup>できます。そのほか、これまで装置を設置する際に必要だった防火設備や工場へのIPA回収処理施設の設置が不要になるなど、環境に優しく、安全性にも優れた装置となっています。

当社は今後も、環境に配慮した製品開発を一層強化し、市場ニーズに応えることで世界トップシェアを誇る300ミリ対応ウエハー洗浄装置のさらなるシェア拡大を目指します。そして、半導体洗浄装置におけるグローバルスタンダードとしての地位をより強固なものにするとともに、業界の発展に貢献していきます。

- ※1 2008年11月現在
- ※2 バッチ式 複数のウエハーを一度に処理できる方式。
- ※3 当社比

## ●本件についてのお問い合わせ先